



tesa HAF[®] 8410 HS



Produkt Information

Värmeaktiverad film för inbäddning av chip-moduler i smartcard

Produktbeskrivning

tesa[®] HAF 8410 HS är en värmeaktiverad dubbelhäftande brun klisterfilm baserad på reaktiv fenolharts och nitrilgummi.

Ansökan

tesa[®] HAF 8410 HS är utformad för inbäddning av chip-moduler i smartcard där man har högt ställda krav på säkerhet och lång livslängd.

- Avsedd för PVC, ABS, PET och PC-kort
- Bra arbetbarhet i alla vanliga implementeringslinjer
- Fantastisk åldersbeständighet
- Livslång flexibilitet tack vare det höga gummiinnehållet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Ingen | • Total tjocklek | 60 µm |
| • Typ av häftämne | nitrile rubber / phenolic resin | • Färg | amber |
| • Typ av liner | Glassine | | |

Egenskaper

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • Bonding strength (dynamic shear) | 12 N/mm ² |
|------------------------------------|----------------------|

Ytterligare information

Tekniska rekommendationer vid användning med smartcard:

Följande värden är rekommendationer för inledande maskinparametrar. Observera att optimala parametrar i stor utsträckning beror på maskintyp, specifika material för kortets kropp och chip-moduler samt naturligtvis kundspecifika krav.

1. Förlaminering:

Vid förlaminering lamineras klistertejpen på modulremmen. Detta steg kan utföras endera i processen eller fristående. Förlamineringssteget påverkar inte klistertejpens lagringstid. Förlaminerade modulremmar kan förvaras under samma tidsrymd som klistertejpen.

Maskininställning:

- Temperatur 120 – 140 °C

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=08410>



tesa HAF[®] 8410 HS

Produkt Information

Ytterligare information

- Tryck 4 – 6 bar
- Tid 1,5 – 3,0 s

2. Modulbäddning:

Vid modulbäddning stansas de förlaminerade modulerna ut från modulremmen, placeras i korthålligheten och försluts permanent mot kortkroppen med hjälp av värme. I detta steg beror det exakta förloppet på vilken typ av implementeringslinje som används. Numera är de två vanligaste sätten:

En-stepsprocess - maskininställning (låg temperatur):

- Temperatur¹ 160 – 180 °C
- Tryck 65 N/modul
- Tid 2,0 – 4,0 s

En-stepsprocess - maskininställning (hög temperatur):

- Temperatur¹ 180 – 200 #
- Tryck 65 N/modul
- Tid 1,0 – 1,5 s

Flerstegsprocess (2 eller fler uppvärmningsstansningar) - Maskininställning:

- Temperatur¹ 170 – 200 #
- Tryck 65 N/modul
- Tid (för resp. steg) 0,7 – 1,2 s

¹ Temperatur enligt mätning inne i värmestansen

För annan användning ska den specifika smartcard-maskinens parametrar användas. Lagringsförhållanden i enlighet med tesa[®] HAF lagerkoncept.

OBS! Limningsstyrkans värde erhålls vid normala laboratorieförhållanden (medelvärde). Värdet är en garanterad lastningsprofil som kontrolleras för varje tillverkningsparti (material: Etsat aluminium testexemplar/limningsförhållande: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min)



tesa HAF[®] 8410 HS

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=08410>